

## Ptfe 웨이퍼 세척 바스켓 4인치 에칭 랙 산알칼리 내성 맞춤형 마스크 캐리어

품목 번호: PL-CP90



### 소개

반도체 웨이퍼 세척 및 화학 공정용으로 정밀 설계된 PTFE 에칭 바스켓입니다. 이 내산성 고순도 세척 랙은 까다로운 실험실 환경에서 오염을 완전히 방지합니다. 첨단 제조 및 연구 응용 분야의 특정 산업용 마스크 및 웨이퍼 크기에 맞춰 완전 맞춤 제작이 가능합니다.

### 자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 습식 에칭	박막 제거 또는 표면 세척을 위해 실리콘 웨이퍼를 산성 용액에 침지하는 공정	HF 및 기타 공격적인 에칭제에 대한 완전한 내성으로 재료 분해가 전혀 발생하지 않습니다.
포토마스크 세척	특수 화학 세척 및 린싱 공정에서 민감한 석영 마스크를 운반하는 공정	저충격 소재 접촉으로 복잡한 마스크 패턴의 표면 손상을 방지합니다.
태양전지 제조	텍스처링 및 도핑 세척 단계에서 광전지 웨이퍼를 처리하는 공정	높은 처리량 용량과 화학적 안정성으로 전반적인 제조 효율을 향상시킵니다.
MEMS 공정	다양한 화학 에칭 환경에서 미세전자기계시스템을 처리하는 공정	정밀 슬롯 가공으로 교반 중 작고 깨지기 쉬운 부품을 안전하게 고정합니다.
미량 금속 분석	분석 테스트 전에 고순도 산조에서 실험 용기와 용기를 세척하는 공정	금속이 없는 세척 환경을 제공하여 교차 오염을 제거합니다.
나노기술 연구	새로운 화학 용액 및 반응성 환경에서 실험 기판을 처리하는 공정	다양한 온도 및 화학 적합성의 다용성으로 다양한 연구 프로토콜을 지원합니다.

특징	PL-CP90의 사양 세부 정보
모델 번호	PL-CP90
소재 구조	고순도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
웨이퍼 크기 호환성	4인치 (표준) / 완전 맞춤형 크기
슬롯 구성	맞춤형 슬롯 개수 및 피치 간격
화학 내성	산, 알칼리 및 용매에 대한 범용 내성
작동 온도 범위	-200°C ~ +260°C
표면 처리	정밀 CNC 가공 / 초저 표면 조도
핸들 디자인	분리형 또는 고정형 스타일 제공 (맞춤 가능)
배수 디자인	고유동 개방 프레임 형상
제조 방식	중단간 맞춤형 CNC 제조
주문 유형	고객 사양 기반 맞춤 제품